

電子公文

檔 號：

保存年限：

明新學校財團法人明新科技大學 函

機關地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：何宗穎
電子信箱：zyho@must.edu.tw
聯絡電話：(03)5593142分機3270
傳真電話：(03)5595142

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國113年11月25日
發文字號：明新(半)字第1130013365號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：附件如說明一(附件2.明新科技大學113學年度教師產業研習活動海報1份
220d0409ae3496d60df80cfa684bac85_1131201975_2_ATTCH2.png、附件1.明新
科技大學113學年度教師產業研習課程簡章1份
220d0409ae3496d60df80cfa684bac85_1131201975_1_ATTCH1.pdf)

主旨：有關本校辦理113學年度教師產業研習「半導體封裝製程
與實務應用培訓營」培訓課程，請轉知貴校工程專業領
域之教師報名參加，活動資訊詳如說明，請查照。

說明：

一、旨揭培訓課程由專家學者與業師共同授課，講授封裝技
術演變所衍生的專業知識、實務技能及異質整合先進封
裝的發展趨勢。在實務應用使用晶圓切割機、固晶機、
打線機及QFN自動化設備。先藉由設備實務操作及製程
參數設定的訓練，了解封裝的基礎製程，再透過機台實
務問題導入，讓學員在企業顧問的經驗分享下，能針對
實務痛點進行專家提點、策略思索、解決方案及預防措
施等程序，了解解決問題的要訣，檢附研習課程之活動
簡章(附件1)及活動海報(附件2)。

二、研習相關資訊：

(一)本研習課程分兩梯次研習時段：

- 1.第一梯次：114年1月13日(星期一)至114年1月24日(星
期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。
- 2.第二梯次：114年6月30日(星期一)至114年7月11日(星



裝

訂

線

國立勤益科技大學



1130063016 113/11/25

期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：本校逢喜樓209教室、半導體封裝測試類產線基地。

(三)參加培訓人數40人（名額有限滿額為止）。

三、報名方式：

(一)報名時間：即日起至114年1月8日

(二)報名網址：<https://forms.gle/diykgwJHbWzRNGDi8>

四、報名洽詢：本校半導體學院類產線計畫辦公室何宗穎助理，電話：(03)5593142分機3270

正本：各公私立高級職業學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、電子工程系、產學及技術移轉中心

113/11/25
14:53:39

裝

訂

線



113學年度教師產業研習 半導體封裝製程與 實務應用培訓營

課程簡介

本課程由專家學者與業師共同授課，講授封裝技術演變所衍生的專業知識、實務技能及異質整合先進封裝的發展趨勢。在實務應用使用晶圓切割機、固晶機、打線機及QFN自動化設備。先藉由設備實務操作及製程參數設定的訓練，了解封裝的基礎製程，再透過機台實務問題導入，讓學員在企業顧問的經驗分享下，能針對實務痛點進行專家提點與策略思索、解決方案及預防措施等程序，了解解決問題的要訣。

課程時間 / 地點

第一梯次

114/01/13(一)至114/01/24(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

第二梯次

114/06/30(一)至114/07/11(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

明新科大逢喜樓209教室

明新科大半導體封裝測試類產線基地

合作廠商

- 明志科技大學
教師產業研習研究專案辦公室
- 工研院電子與光電系統所
異質整合智能系統組
- 力成科技股份有限公司
- 廣化科技股份有限公司

參與對象/報名資訊

高中職及大專院校教師

報名時間：即日起至114年1月8日

報名網址：

<https://forms.gle/diykgwJHbWzRNGDi8>

名額40位滿額為止



明新科大(報名)



明新科大(簡章)

聯絡人

明新科技大學半導體學院

半導體人才培育基地辦公室

何宗穎助理

TEL : 03-5593142 #3270



明新科技大學113學年度教師產業研習

半導體封裝製程與實務應用培訓營課程簡章

主辦單位 明新科技大學

第一梯次(10天，共70小時)

課程時間
/ 課程名稱/師資

日期	時間	培訓內容	講員	服務機構及職稱
1/13 (一)	8:30 – 12:00	半導體構裝技術的演變	羅勉成	世芯電子公司專案顧問
	13:00 – 16:30	認識晶圓切割機組成與功能	何信松	力成科技公司資深工程師
1/14 (二)	8:30 – 12:00	IC 先進製程的發展	呂明峯	明新科技大學 電子工程系教授
	13:00 – 16:30	晶圓切割機人機介面參數設定	何信松	力成科技公司資深工程師
1/15 (三)	8:30 – 12:00	半導體封裝綜覽	蔡天寶	力成股份有限公司 封裝製造暨設備整合處處長
	13:00 – 16:30	晶圓切割機檢測與基本故障排除	何信松	力成科技公司資深工程師
1/16 (四)	8:30 – 12:00	基礎半導體封裝概論	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	晶圓切割機實務程序操作	何信松	力成科技公司資深工程師
1/17 (五)	8:30 – 12:00	半導體封裝第一階層連接方式	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	認識固晶機組成與功能	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/20 (一)	8:30 – 12:00	典型封裝製程技術	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長



	13:00 – 16:30	固晶機人機介面參數設定	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/21 (二)	8:30 – 12:00	多晶片封裝模組製程技術	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	固晶機檢測與基本故障排除	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/22 (三)	8:30 – 12:00	先進封裝概論	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	固晶機實務程序操作	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/23 (四)	8:30 – 12:00	晶圓級封裝	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	認識 QFN 封裝設備組成與功能	鄭國偉	廣化科技股份有限公司 業務處經理
1/24 (五)	8:30 – 12:00	面板級封裝	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	QFN 封裝設備人機介面參數設定	陳慶恩	廣化科技股份有限公司 關鍵技術研發處 資深研發工程師



第二梯次(10天，共70小時)

日期	時間	培訓內容	講員	服務機構
6/30 (一)	8:30 – 12:00	IC 先進製程整合先進封裝的需求	呂明峯	明新科技大學 電子工程系教授
	13:00 – 16:30	QFN 封裝設備檢測與基本故障排除	陳慶源	廣化科技股份有限公司 生產處資深工程師
7/1 (二)	8:30 – 12:00	先進封裝的發展趨勢	王欽宏	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組組長
	13:00 – 16:30	QFN 封裝設備實務程序操作	陳慶源	廣化科技股份有限公司 生產處資深工程師
7/2 (三)	8:30 – 12:00	先進封裝的技術挑戰	張香鉞	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組經理
	13:00 – 16:30	認識打線機組成與功能	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/3 (四)	8:30 – 12:00	先進封裝製程實務	張香鉞	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組經理
	13:00 – 16:30	打線機人機介面參數設定	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/4 (五)	8:30 – 12:00	晶圓切割機實務問題導入演練	龐思全	矽格股份有限公司 封裝製程處長退休
	13:00 – 16:30	打線機檢測與基本故障排除	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/7 (一)	8:30 – 12:00	黏晶機實務問題導入演練	龐思全	矽格股份有限公司 封裝製程處長退休
	13:00 – 16:30	打線機實務程序操作	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/8 (二)	8:30 – 12:00	打線機實務問題導入演練	龐思全	矽格股份有限公司 封裝製程處長退休
	13:00 – 16:30	晶圓切割機操作能力檢測	何信松	力成科技公司資深工程師
7/9 (三)	8:30 – 12:00	IC 封裝產業環境汙染處理	江鏞帆	力成股份有限公司 工安二部副部經理
	13:00 – 16:30	固晶機操作能力檢測	林賢昇	力成科技公司資深工程師
7/10 (四)	8:30 – 12:00	封裝產業廠務系統介紹	盧麒泰	力成股份有限公司 廠務副部經理



	13:00 – 16:30	打線機操作能力檢測	黃志賢	力成科技公司資深工程師
	8:30 – 12:00	半導體封裝製程學習評量	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	半導體封裝設備核心實務評量	蔡天寶	力成股份有限公司 封裝製造暨設備整合處處長
開課日期	第一梯次: 114年1月13日(一)至114年1月24日(五) 每周一至周五 早上8:30至16:30 第二梯次: 114年6月30日(一)至114年7月11日(五) 每周一至周五 早上8:30至16:30			
開課地點	明新科技大學逢喜樓(209教室)、半導體封裝測試類產線基地			
合作機構	明志科技大學教師產業研習研究專案辦公室 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組 力成科技股份有限公司 廣化科技股份有限公司			
參與對象	高中職及大專院校教師			
收費標準	免費			
招生人數	招生人數40人			
報名網址	https://forms.gle/diykgwJHbWzRNGDi8			